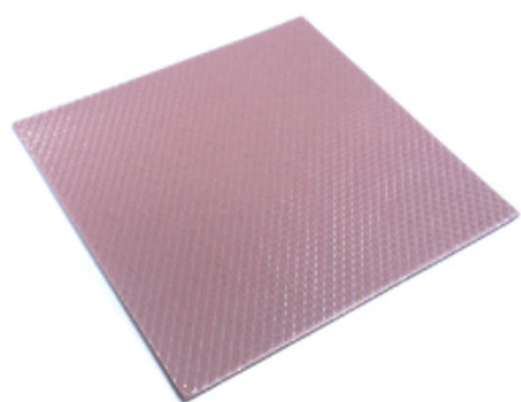


α-オレフィン系材料を使用しており、従来のシリコーン系材料で懸念されていた低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害を引き起こしません。



製品カタログはこちら

型番	WW-SF-B10
熱伝導率	2.0W/m・K
使用温度範囲	-40℃～110℃
JANコード	4524945012028
寸法	100mm×100mm×厚さ1.0mm

仕様	<p>ベースポリマー α-オレフィン                  硬さ 35 (JIS Type E)                  比重 1.8                  体積抵抗値 <math>\geq 1 \times 10^{10}</math> の10乗 (<math>\Omega \cdot \text{cm}</math>)                  絶縁破壊電圧 <math>\geq 10</math> (AC kV/mm)                  耐電圧 <math>\geq 10</math> (AC kV/mm)                  難燃性 V-0 (UL94)                  片面粘着、シリコーンフリー                  RoHS 2.0適合                  絶縁性                  本製品はCEマークは取得されておりません。</p>
----	---

製品PR	<ul style="list-style-type: none"> <li>発熱体にシートを貼り、熱を伝導させたい放熱体に密着させ使用します。(熱源と放熱体の間に挟んで使用します。)</li> <li>発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)とのすきま(ギャップ)や凹凸を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。</li> <li>熱に対しては高い放熱性を発揮し、電気的には絶縁性を持った柔軟性に富む熱伝導材です。また、難燃性を有し、作業性・加工性に優れた放熱シートです。</li> <li>柔らかい素材ですので、基板へのストレスの軽減、また半導体チップへの過度の圧力による悪影響を防止できます。</li> <li>復帰性が良好でリワーク性に優れます。</li> </ul>
------	--

備考	<p><u>低分子シロキサン電気接点障害とは</u>                  従来のシリコーン系材料では、発熱体の動作熱により低分子シロキサンが発生し、電気接点障害を誘発することがあります。                  誘発する例としましては、リレーの接点不良が多く、密閉された環境下でシリコーンを使用していると、シロキサンが発生し、リレー接点上に付着します。特にON/OFF回数の多いリレーは接点のON/OFFを繰り返すことにより、接点上に付着したシロキサンを酸化分解させ、二酸化ケイ素(SiO<sub>2</sub>)となり、電気絶縁物として接点障害を引き起こします。</p>
----	--